

华虹半导体有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”、“华虹公司”或“华虹半导体”）为持续贯彻落实上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“以投资者为本”的发展理念，特制定《华虹半导体有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，在总结 2025 年行动方案实施成效的基础上，规划 2026 年度的关键行动，推动公司实现高质量可持续发展，不断提升综合股东回报。

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估

公司紧密围绕 2025 年度行动方案的各项举措，聚焦晶圆代工主业，深化“8 英寸+12 英寸”协同发展、先进“特色 IC+功率器件”双轮驱动的核心战略，积极应对全球半导体市场的结构性机遇，在经营质量与技术创新、公司治理与投资者关系等方面取得显著成效。

经营质量与技术创新方面，受益于 AI 及其相关产品需求拉动、国内消费类需求回暖，结合系统性运营效率优化措施，公司 2025 年产能维持高位运行，8 英寸和 12 英寸平均产能利用率均保持在 100% 以上，全年共实现营业收入 RMB 172.91 亿元，同比增长 20.18%。其中，华虹制造项目（FAB9）产能快速爬坡，推动 12 英寸营收占比上升和产品结构的不断优化。同时，公司加速推进核心技术迭代，五大

工艺平台均取得关键突破，全年研发投入 19.94 亿元，占营收比例 11.53%，同比增加 0.11 个百分点，新增授权专利 306 项，技术积累进一步夯实。

公司治理与投资者关系方面，2025 年，公司严格遵守沪港两地上市规则，根据证监会最新监管要求，完成《关连（联）交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《市值管理制度》等多项制度修订与建立，全年召开股东大会 1 次、董事会 9 次，各专门委员会均保持规范运作。公司 ESG 管理持续深化，绿色制造与公益事业稳步推进。投资者关系方面，全年召开业绩说明会 4 次，通过上证 E 互动、投资者热线等渠道与市场保持及时沟通。此外，公司适时启动华力微并购事宜，履行 A 股 IPO 上市承诺并着力解决同业竞争业务，有效支持市值管理，切实增强投资者的获得感。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年，公司将以技术创新为驱动，以精益管理为支撑，全面贯彻落实“提质增效重回报”专项行动要求，重点推进以下工作：

（一）深耕主业，创新驱动，提升经营质效

1、深化工艺研发，筑牢技术护城河

公司秉持“知难而进、奋发图强”的企业精神，以持续创新为核心驱动力，怀揣“铸就全球客户‘芯’梦想”的愿景，将在继续加大

研发投入、推动特色工艺平台迭代升级的基础上，进一步深化国内外市场拓展与合作，持续巩固与强化核心竞争力。

未来，公司将聚焦核心工艺平台的前沿技术突破。40 纳米特色工艺方面，公司将在标准平台基础上进一步开发衍生平台，优化高密度 SRAM 性能，匹配市场多元化应用需求。新一代独立式闪存（4X NOR FLASH）方面，公司将继续针对大容量、低功耗需求持续进行产品优化。40 纳米嵌入式闪存将于 2026 年完成平台开发，并满足车规级需求。在 90 纳米 BCD 领域，新一代技术平台将进一步提升功率器件优值和安全工作区，同时公司将开发与闪存集成的平台，可满足车规级应用需求。针对新一代功率器件，公司将在完成平台开发的基础上，逐步推进更高电压、更大电流的技术平台开发，进一步拓展高压大电流应用场景。

2026 年，预计公司研发投入金额及营收占比都保持不低于 2025 年的水平，研发团队质量持续提升，专利申请及获授权数量预计也将继续增长。同时，通过自身艺平台迭代、客户产品协同研发、产学研合作、第三方 IP 支持等多重渠道投入，公司将进一步缩短产品研发周期，加速工艺平台量产转化，完善“需求-研发-转化”闭环，持续提升研发效率。凭借强大的研发能力与深厚的工艺积累，公司将持续巩固晶圆代工核心优势，助力国内半导体产业链升级，为新质生产力的加速成型提供坚实支撑。

2、推进产能建设，提升运营效率

2026 年，公司将坚定不移推进“8 英寸+12 英寸”协同发展战略，

持续优化产能布局，维持高效产能利用率，同时加快推进新产线的产能爬坡。预计全年 8 英寸和 12 英寸平均产能利用率均保持高位，保持全球晶圆代工行业领先水平。公司将高效推进华虹制造项目（FAB9）产能建设，计划于 2026 年三季度达成规划产能目标 8.3 万片/月。此外，公司将推动产能的灵活配置与高效利用，持续优化营收结构与经营效率，预计规模效应将进一步显现。

在运营管理方面，公司将坚持精益管理策略，持续深化降本增效举措，通过数字化、智能化手段优化生产调度与供应链管理，深化供应商战略协同，建立多元化供应体系以应对国际贸易摩擦风险，同时完善成本核算与管控体系，力争实现单位成本有效节降，实现存货周转率及资产周转效率有效提升。

未来，公司将以产能布局的优化夯实发展根基，以运营管理的精益求精提升竞争韧性。通过巩固规模化优势与强化精细化管理的协同发力，进一步增强应对市场波动的抗风险能力，为实现高质量发展筑牢可持续的运营底座。

（二）优化治理，回报股东，构建价值共同体

1、完善公司治理，夯实合规根基

公司致力于保持高水平企业治理，保障股东权益、提升企业价值与问责性。2026 年，公司将密切跟踪监管政策动态，及时修订和完善现有管理制度、流程等，确保与最新监管要求衔接，为公司稳健合规经营提供坚实保障。同时，公司也将积极响应监管精神，优化各层

级法人治理结构，强化独立董事监督机制、控股股东责任意识及核心人员合规意识，推动公司治理与运作持续规范、稳健发展。

2026年，公司将继续深化ESG治理实践，不断提升可持续发展能力，为股东、员工、客户及社会创造长期稳定价值。环境方面，公司将构建全周期绿色运营体系，发力清洁生产技术应用与绿色产业链布局，打造行业可持续发展标杆。社会方面，公司将进一步强化人才队伍建设，完善管理、技术、职能多轨道职业发展通道，切实保障职工权益与福利，同时积极参与社区公益，持续开展无偿献血、乡村振兴等公益活动，彰显企业社会担当。治理方面，在上市公司公司治理体系的基础上，进一步强化商业道德与反腐败体系建设，《廉洁从业承诺书》关键岗位目标覆盖率100%，确保合规经营。

2、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司将科学制定董事与高级管理人员的薪酬管理制度，促使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。根据新《公司法》等法律法规的规定，公司将通过加强合规培训与履职监督，切实增强控股股东、董监高等“关键少数”的合规意识、责任意识与履职能力。

3、构建长效回报机制，增强投资者获得感

公司高度重视股东回报，将在兼顾资本开支与稳健经营的前提下，做好业绩增长与股东回报的动态平衡。考虑到国内半导体与晶圆代工行业的发展阶段和实际情况，在分红、回购等传统市值管理工具之外，积极拓展包括并购、业务拓展、股权激励等形式在内的多维措施，全力提升公司核心竞争力，让投资者共享公司综合发展成果，切实增强

投资回报的稳定性、及时性和可预期性。

2026年，公司将继续推进重大资产重组事项，以期进一步提升公司的综合实力与股东价值。截至本方案发布日，本次交易已获公司股东大会审议通过及上海市国资委批复，尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。后续，公司将积极配合审核工作，并及时披露相关进展。

4、加强投资者沟通，提升信息披露透明度

2026年，公司将严格遵守两地上市规则，优化内部信息报送流程，做好与监管机构、股东、董事及高级管理人员等的高效沟通，及时报告重要事项，并持续优化信息披露的质量和合规性，确保信息披露的真实性、准确性、及时性、公平性和完整性，满足利益相关方的信息需求。

投资者沟通方面，秉持“平等对待所有投资者”原则，公司将通过股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、公司官网及微信公众号等多元化渠道，与投资者保持及时沟通。2026年，公司计划举办业绩说明会不少于4次，完善投资者意见征询和反馈机制，及时回应市场关切，确保投资者的合法权益得到有效保障。结合新《公司法》强化中小股东权益保护的立法精神，公司将在股东大会审议重大事项时，为中小投资者提供网络投票便利，切实保障其参与权和知情权，对中小投资者表决单独计票，并及时公告计票结果。同时，公司将认真听取机构投资者在公司治理、ESG等方面的意见建议，通过持续双向沟通，有效提升机构投资者参与公司治理的深度与广度。

2026年，公司将以规范化为基础、透明化为保障、积极化为导向，在严格遵守监管要求的前提下，持续完善信息披露、加强投资者沟通，建立与华虹公司的行业地位相符合的优质资本市场形象，增强资本市场认同感，与投资者共享公司成长价值。

三、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于当前经营环境、行业趋势及未来规划所做出的展望性陈述，各项举措的后续实施会受到宏观经济、市场变化、监管政策、经营决策等各方面因素影响，存在不确定性。因此方案所涉及的公司业务规划、财务目标等系非既成事实性的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026年3月27日